附件 1

享受税收优惠政策的企业条件和项目标准

一、《若干政策》第 (一) 条提及的国家鼓励的集成电路线宽 小于 28 纳米(含)、线宽小于 65 纳米(含)、线宽小于 130 纳米(含) 的集成电路生产企业或项目享受税收优惠政策条件如下：

 ( 一 ) 在中国境内 (不包括港、澳、 台地区) 依法注册并具有 独立法人资格的企业；

 ( 二 ) 符合国家布局规划和产业政策；

 ( 三 ) 汇算清缴年度 ，具有劳动合同关系或劳务派遣、聘用关 系，其中具有本科及以上学历月平均职工人数占企业月平均职工总 人数的比例不低于 30%，研究开发人员月平均数占企业月平均职工 总数的比例不低于 20%(从事 8 英寸及以下集成电路生产的不低于 15%)；

 ( 四 ) 企业拥有关键核心技术和属于本企业的知识产权 ，并以 此为基础开展经营活动，且汇算清缴年度研究开发费用总额占企业 销售 ( 营业) 收入 ( 主营业务收入与其他业务收入之和) 总额的比 例不低于 2% (本条及下述研究开发费用政策 口径 ，按照《财政部、 国家税务总局、科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的 通知》(财税〔 2015 〕119 号 ) 和《国家税务总局关于研发费用税前 加计扣除归集范围有关问题的公告》( 国家税务总局公告 2017 年第

40 号 ) 的规定执行)；

 ( 五 ) 汇算清缴年度集成电路制造销售 ( 营业) 收入占企业收 入总额的比例不低于 60%；

 ( 六) 具有保证相关工艺线宽产品生产的手段和能力；

 ( 七 ) 汇算清缴年度未发生重大安全、重大质量事故或严重环 境违法行为；

 (八) 对于按照集成电路生产项目享受税收优惠政策的 ，项 目 主体企业应符合相应的集成电路生产企业条件，且能够对该项目单 独进行会计核算、计算所得 ， 并合理分摊期间费用。

二、《若干政策》第 (三) 、(七) 条提及的国家鼓励的重点集 成电路设计企业享受税收优惠政策条件，除符合《中华人民共和国 工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、国家税务总局公告 2021 年第 9 号》规定的国家鼓励的集成电路设计企业条件外，还应符合 以下条件：

 ( 一 )汇算清缴年度具有劳动合同关系或劳务派遣、聘用关系， 其中具有本科及以上学历月平均职工人数占企业月平均职工总人 数的比例不低于 50%，研究开发人员月平均数占企业月平均职工总 数的比例不低于 40%；

 ( 二 ) 拥有关键核心技术 ，并以此为基础开展经营活动 ，且汇 算清缴年度研究开发费用总额占企业销售 ( 营业) 收入 ( 主营业务 收入与其他业务收入之和) 总额的比例不低于 6%；

 ( 三 ) 汇算清缴年度集成电路设计 (含EDA 工具 、IP 和设计

服务，下同)销售( 营业) 收入占企业收入总额的比例不低于 70%， 其中集成电路自主设计销售 ( 营业) 收入占企业收入总额的比例不 低于 60% ； 对于集成电路设计销售 ( 营业) 收入超过 50 亿元的企 业 ， 汇算清缴年度集成电路设计销售 ( 营业) 收入占企业收入总额 的比例不低于 60% ，其中集成电路自主设计销售 ( 营业) 收入占企 业收入总额的比例不低于 50%；

 ( 四 ) 企业拥有核心关键技术和属于本企业的知识产权 ，企业 拥有与集成电路产品设计相关的已授权发明专利 (企业为第一权利 人)、布图设计登记、计算机软件著作权合计不少于8 个。

除以上条件外 ，还应至少符合下列条件中的一项：

 ( 一 ) 汇算清缴年度 ，集成电路设计销售 ( 营业) 收入不低于 5 亿元，应纳税所得额不低于 3000 万元；对于集成电路设计销售( 营 业 ) 收入不低于 50 亿元的企业 ， 可不要求应纳税所得额 ， 但研究 开发费用总额占企业销售 ( 营业) 收入 ( 主营业务收入与其他业务 收入之和) 总额的比例不低于 8%。

 ( 二 ) 在国家鼓励的重点集成电路设计领域内 ( 附件 2 ) ，汇算 清缴年度集成电路设计销售 ( 营业) 收入不低于 3000 万元 ， 应纳 税所得额不低于 350 万元。

三、《若干政策》第 (三) 、(七) 条提及的国家鼓励的重点软 件企业享受税收优惠政策条件，除符合《中华人民共和国工业和信 息化部、国家发展改革委、财政部、国家税务总局公告 2021 年第 10 号》规定的国家鼓励的软件企业条件外，还应至少符合下列条件

中的一项：

 ( 一 ) 专业开发基础软件、研发设计类工业软件的企业 (具体 领域说明见附件 2，下同)，汇算清缴年度软件产品开发销售及相关 信息技术服务 ( 营业) 收入 (其中相关信息技术服务是指实现软件 产品功能直接相关的咨询设计、软件运维、数据服务 ，下同) 不低 于 5000 万元； 汇算清缴年度研究开发费用总额占企业销售 ( 营业) 收入总额的比例不低于 7%；

 ( 二 ) 专业开发生产控制类工业软件、新兴技术软件、信息安 全软件的企业 ，汇算清缴年度软件产品开发销售及相关信息技术服 务 ( 营业) 收入不低于 1 亿元； 应纳税所得额不低于 500 万元；研 究开发人员月平均数占企业月平均职工总数的比例不低于 30%；汇 算清缴年度研究开发费用总额占企业销售 ( 营业) 收入总额的比例 不低于 8%；

 ( 三 ) 专业开发重点领域应用软件、经营管理类工业软件、公 有云服务软件、嵌入式软件的企业 ， 汇算清缴年度软件产品开发销 售及相关信息技术服务 ( 营业) 收入不低于 5 亿元 ，应纳税所得额 不低于 2500 万元； 研究开发人员月平均数占企业月平均职工总数 的比例不低于 30% ； 汇算清缴年度研究开发费用总额占企业销售 ( 营业) 收入总额的比例不低于 7%。

四、《若干政策》第 ( 六 ) 条提及的集成电路线宽小于 65 纳米 ( 含 ) 的逻辑电路、存储器生产企业、线宽小于 0.25 微米 ( 含 ) 的 特色工艺集成电路生产企业、集成电路线宽小于 0.5 微米 ( 含 ) 的

化合物集成电路生产企业，以及财关税〔2021〕4 号文提及的集成 电路产业的关键原材料、零配件 ( 靶材、光刻胶、掩模版、封装载 板、抛光垫、抛光液、8 英寸及以上硅单晶、8 英寸及以上硅片 ) 生产企业享受税收优惠政策条件如下：

 ( 一 ) 在中国境内 (不包括港、澳、 台地区) 依法注册并具有 独立法人资格的企业；

 ( 二 ) 符合国家布局规划和产业政策；

 ( 三 ) 具有保证产品生产的手段和能力；

 ( 四 ) 汇算清缴年度未发生重大安全、重大质量事故或严重环 境违法行为。

五、《若干政策》第 ( 六 ) 条提及的先进封装测试企业享受税 收优惠政策条件如下：

 ( 一 ) 在中国境内 (不包括港、澳、 台地区) 依法注册并具有 独立法人资格的企业；

 ( 二 ) 符合国家布局规划和产业政策；

 ( 三 ) 汇算清缴年度企业先进封装测试 ( 晶圆级封装、系统级 封装 、2.5 维和 3 维封装) 规划产能占总规划产能比例 ， 按封装产 品颗粒数或晶圆数 (折合 8 英寸) 计算不低于 40%；

 ( 四 ) 具有保证产品生产的手段和能力；

 ( 五 ) 汇算清缴年度未发生重大安全、重大质量事故或严重环 境违法行为。

六、《若干政策》第 (八) 条提及的集成电路重大项目企业享

受税收优惠政策条件，除承建企业应符合本通知第四、五条的相对 应规定条件外，项目还应符合下列对应条件中的一项：

 ( 一 ) 芯片制造类重大项 目 ， 需同时满足以下条件： 1.符合国家布局规划和产业政策； 2.对于不同工艺类型芯片制造项 目 ， 需分别满足以下条件：

 ( 1 ) 对于工艺线宽小于 65 纳米 (含) 的逻辑电路、存储器项

目，固定资产总投资额需超过80 亿元，规划月产能超过 1 万片(折 合 12 英寸 )；

 (2) 对于工艺线宽小于 0.25 微米 (含) 的模拟 、数模混合 、 高压、射频、功率、光电集成、 图像传感、微机电系统、绝缘体上 硅工艺等特色芯片制造项 目 ， 固定资产总投资额超过 10 亿元 ， 规 划月产能超过 1 万片 (折合 8 英寸)；

 (3) 对于工艺线宽小于 0.5 微米 (含) 的基于化合物集成电路 制造项 目 ， 固定资产总投资额超过 10 亿元 ， 规划月产能超过 1 万 片 (折合 6 英寸 )。

 ( 二 ) 先进封装测试类重大项 目 ， 需同时满足以下条件：

1. 符合国家布局规划和产业政策；

2. 固定资产总投资额超过 10 亿元；

3. 封装规划年产能超过 10 亿颗芯片或 50 万片晶圆(折合 8 英

寸 )。